MInt.Cl. H 01 f

60日本分類 59 F 11 59 F 0

日本国特許庁

①実用新案出願公告 昭45-33405

⑩実用新案公報

昭和45年(1970)12月19日 49公告

(全2頁)

1

59小型インダクタンス素子

願 昭43-35861 ②)実

昭43(1968)5月2日 22出

曹一二 四考 案 者

長野県下伊那郡鼎町大字鼎359

簾内文夫 同

同所

勿出 願 人 東京電気化学工業株式会社

東京都千代田区内神田2の14の

6

代 表 者 山崎貞一

代 理 人 弁理士 星野恒司

図面の簡単な説明

第1図は従来の小型インダクタンス素子の正断 面図、第2図は本考案小型インダクタンス案子の 一実施例の正断面図、第3図は第2図に示した端 た本考案小型インダクタンス素子の製造工程を説 明するための説明図をそれぞれ示す。

考案の詳細な説明

本考案は、例えば広帯域増幅器に用いるピーキ 関する。

従来、小型インダクタンス素子としては、例え は第1図に示すようなものが良く知られている。 即ち、鼓状磁心5に巻線4を施し、鼓状磁心5の 鍍金層 8 を施し、この銀鍍金層 8 の部分に巻線 4 のリード線7と導出線1の端部を配置して半田に よつて全部同時に固着し、絶縁物りを施して完成 するものである。ところで、例えばピーキングコ イルのように比較的低価格の電子機器にも多数用 35 るので製作費は著しく低下する。 いられるものに銀のような貴金属を用いていたの ではコスト的に引合わない。

本考案は、巻線を施すとともに両端面にくぼみ を設けてなる磁心と、一端にわん状部を持つとと

2

もに該わん状部を前記巻線のリード線を介して前 記くぼみに嵌合してなる端子とを備えた小型イン ダクタンス素子を提案し、小型インダクタンス素 于に銀を用いなくても端子等の接触が良好で、し 5 かも組立を容易にしようとするものである。以下 これを図面を参照しつゝ詳細な説明する。

第2図は本考案小型インダクタンス素子の一実 施例の正断面図で、巻線4が施された鼓形磁心5 にはその両端面に円錐状くばみ8が形成され、円 10 錐状くぼみ8には端子1のわん状部2が巻線4の リード線7を介して嵌合され、わん状部2とリー ド線7との接触部分を半田で固定し、絶縁部9を 施して完成する。

第3図は第2図に示した端子1の斜視図で、わ 15 ん状部2が明瞭に表わされている。

さて、以上説明した本考案小型インダクタンス 素子を大量生産する場合は次に説明する順序で組 立てると非常に有利である。即ち、第4図はその 製造工程を説明するための説明図で、先ず、阿燐 子の斜視図、第4図は第2図並びに第3図に示し 20 面に円錐状くぼみ8を形成した鼓形磁心5に巻標 4を施し、巻線4のリード線7の端部を円錐状く ばみ8の表面に接触させ、両端にわん状部2を持 つ略U字状クリップ11 のわん状部2を円錐状く ほみ8に嵌合して鼓状酸心5を挟持し、全体を半 ングコイル等と小型インダクタンス案子の改良に 25 田槽中に浸漬してリード線7とわん状部2とを固 定し、鼓形磁心5近傍を絶縁物9で被覆し、略U 字状クリップ11 の阻曲点10,101 を切断し て完成する。

以上の説明で判るように、本考案小型インダク 阿側端面に形成された円錐状くぼみ8の表面に銀 30 タンス素子においては、リード線の端子に対する 固着がきわめて容易であり、接触が良好であるか ら従来のもののように導電性を良くするために銀 を用いる等の必要がなく、組立も容易であるから 材料費が節約されるとともに作業工程も簡単にな

実用新案登録請求の範囲

巻線を施すとともに両端面にくぼみを設けてな る磁心と、一端にわん状部を持つとともに該わん 状部を前記巻線のリード線を介して前記くぼみに

3

嵌合してなる端子とを備えた小型インダクタンス 素子。

